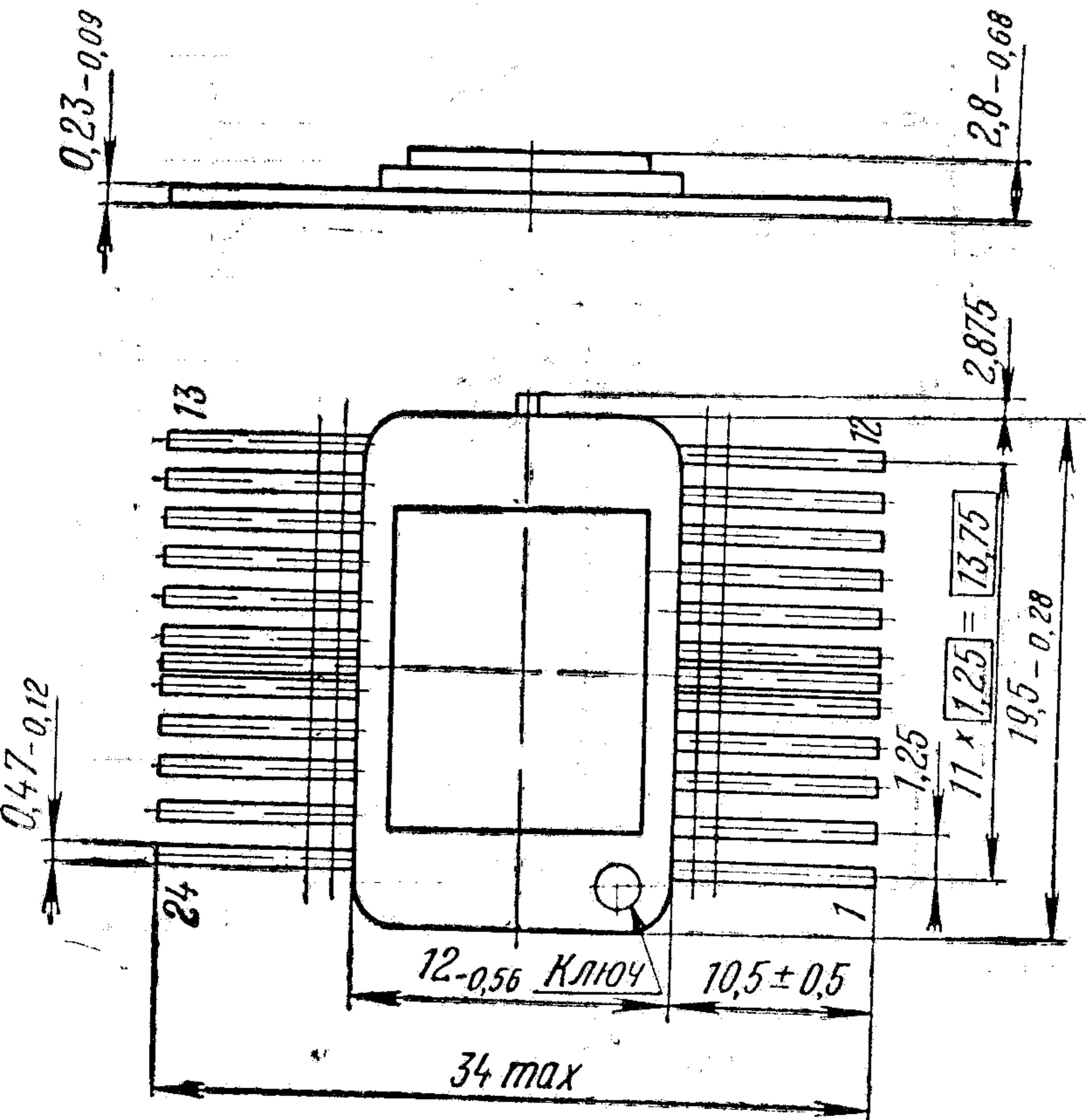


МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 528

Общие данные

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ МИКРОСХЕМ 528БР2 (корпус 405.24-2)



ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Нумерация выводов микросхем показана условно.

Синусоидальная вибрация:

диапазон частот, Гц	от 1 до 5000
амплитуда ускорения, $m \cdot c^{-2}$ (g)	400 (40)

Механический удар:

одиночного действия:

пиковое ударное ускорение, $m \cdot c^{-2}$ (g)	15 000 (1500)
длительность действия ударного ускорения, мс	от 0,1 до 2

многократного действия:	
пиковое ударное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g)	1500 (150)
длительность действия ударного ускорения, мс	от 1 до 5
Линейное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g)	5000 (500)
Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт. ст.)	665 (5)
Атмосферное повышенное давление, атм	3
Повышенная температура среды, °С:	
для микросхемы 528ХК1	85
для микросхем 528БР1, 528БР2, 528ФВ1	70
Пониженная температура среды, °С	минус 60
Изменения температуры среды, °С:	
для микросхемы 528ХК1	от минус 60 до +85
для микросхем 528БР1, 528БР2, 528ФВ1	от минус 60 до +70
Иней, роса.	
Соляной туман.	
Среда, зараженная плесневыми грибами.	

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка*, ч	50 000
Срок сохраняемости*, лет	25

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ОСТ В 11 073.041—82 и требованиями, изложенными ниже.

Допустимое значение статического потенциала 30 В.

Приклейку микросхем производить клеем АК-20. Допустимая толщина клея не более 0,4 мм.

При пайке микросхем групповым способом температура жала паяльника не более 265°С, время воздействия не более 2 с, расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм, интервал между двумя повторными пайками одной микросхемы не менее 5 мин. При пайке рекомендуется применять припой ПОС Су-61-0,5 и флюс ФКСп.

Микросхемы в блоках аппаратуры, при необходимости, покрывают влагозащитным лаком УР-231 или ЭП-730. Количество слоев — 3.

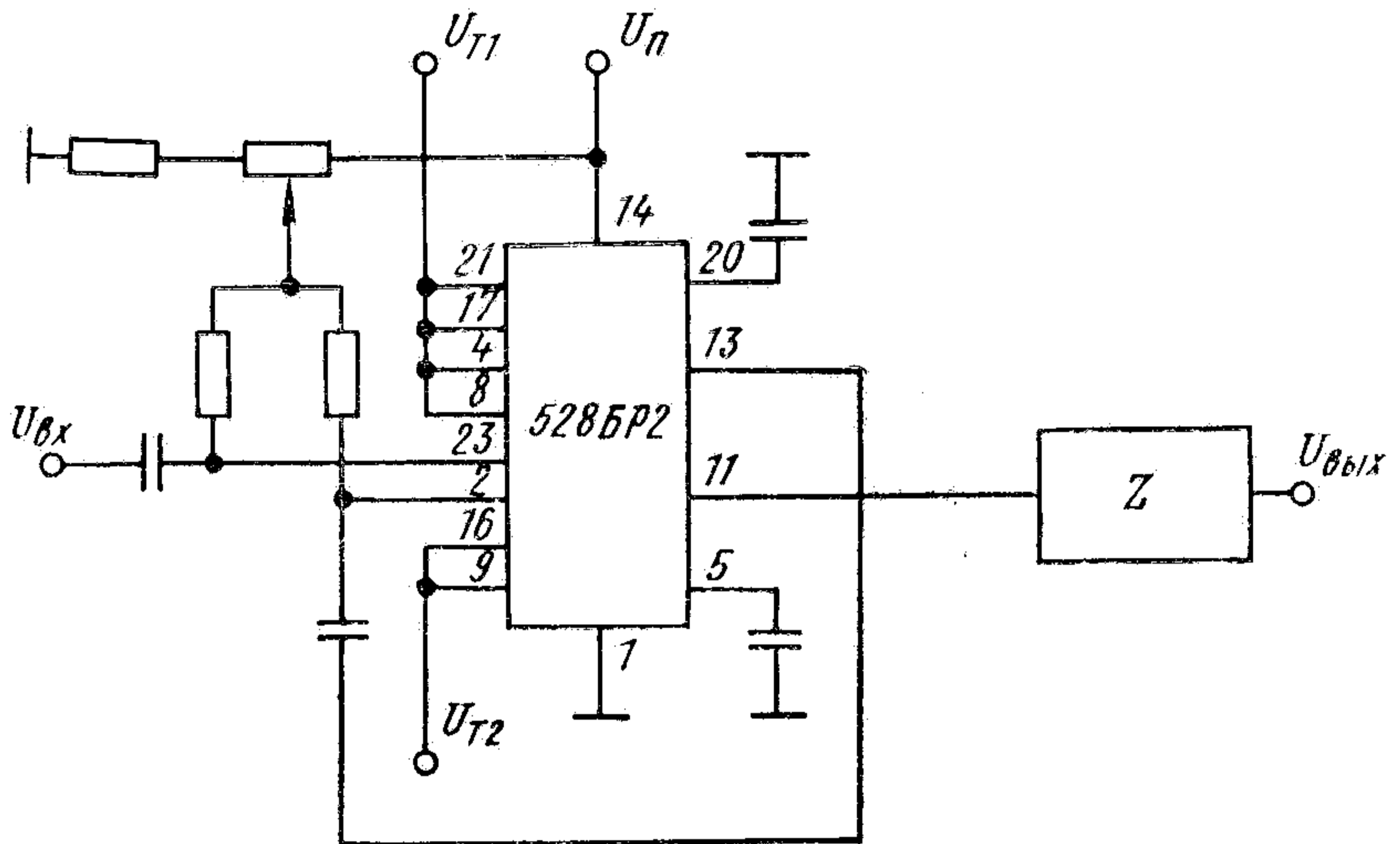
При хранении, транспортировании и обращении микросхемы должны находиться в упаковке завода-изготовителя, обеспечивающей закорачивание всех выводов. Выводы плат с микросхемами во время распайки, лакировки, хранения, транспортирования должны быть замкнуты и по возможности заземлены.

* В условиях и режимах, допускаемых ОТУ или ТУ.

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

- | | | |
|------------------|----------------|--------------------|
| 1 — подложка | 9 — $U_T(2-2)$ | 16 — $U_T(2-1)$ |
| 2 — вход 2 | 10 — свободный | 17 — $U_T(1-1)$ |
| 3 — свободный | 11 — выход 2 | 18, 19 — свободные |
| 4 — U_{B2} | 12 — U_{CM3} | 20 — U_{CM1} |
| 5 — U_{CM2} | 13 — выход 1 | 21 — U_{B1} |
| 6, 7 — свободные | 14 — U_P | 22, 24 — свободные |
| 8 — $U_T(1-2)$ | 15 — свободный | 23 — вход 1 |

СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ



Z — фильтр нижних частот

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре $25 \pm 10^\circ\text{C}$)

Напряжение питания, В	$15 \pm 2\%$
Напряжение управляющих тактовых импульсов, В	15
Ток потребления, мА, не более	1,8
Коэффициент усиления напряжения	от 0,8 до 1,6
Коэффициент неравномерности АЧХ, дБ, не более	5

Коэффициент гармоник, %, не более	4
Напряжение шумов, приведенное ко входу, мВ, не более	3

Предельно допустимые значения параметров
и режимов эксплуатации

Максимальный ток потребления, мА	1,8
Коэффициент усиления напряжения	от 0,8 до 1,6
Коэффициент неравномерности АЧХ, дБ	5
Приведенное ко входу напряжение шумов, мВ	3
Максимальный коэффициент гармоник, %	4